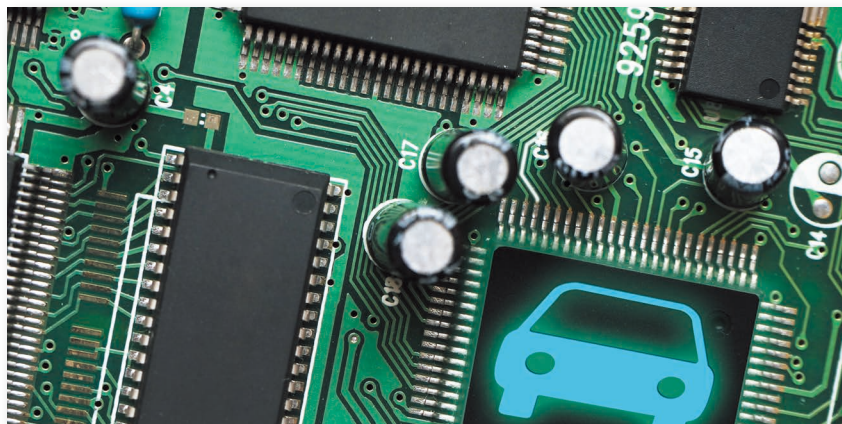


## 電子部材向け 放熱グリース/ギャップフィラー YG/YGFシリーズ

柔軟性と放熱性能を併せ持った、**高機能/低価格な非シリコン系放熱樹脂ペースト**です。  
発熱部材と放熱部材間の接触面積を増加させ、効率的な排熱に貢献します。



### 課題



- 発熱による性能低下
- 密着不良による排熱性能低下
- アウトガス発生
- コスト高

### 熱伝導性

1~5W/m·K

### 高ハンドリング設計

低分子シロキサンフリー  
低粘度設計  
ウレタン特性(柔軟性/密着性)

### 低コスト設計

内製樹脂/フィラー使用  
機械摩擦低減による、  
ランニングコスト低減

## SERIES LINE UP

### C series 1

低コスト・軽量・柔軟性

YG/YGF-C001

**1.8W**設計

Shore C 40

### C series 2

低コスト・軽量・柔軟性

YG/YGF-C002

**2.5W**設計

2.2g/cm<sup>3</sup>

### O series

機械摩擦低減

YG/YGF-001

**3.2W**設計

### M series

高熱伝導

YG/YGF-M001

**4.6W**設計

グリース  
1液

非硬化 / 粘着

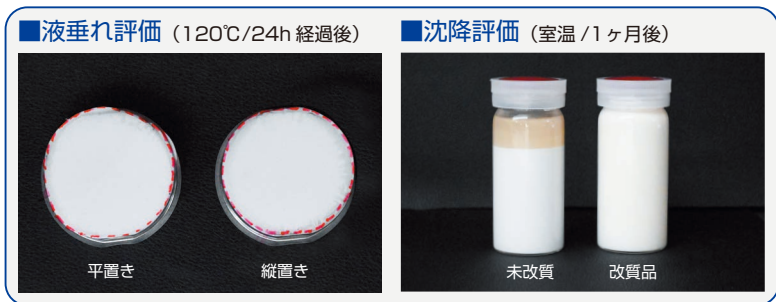
YG series

接着剤  
2液

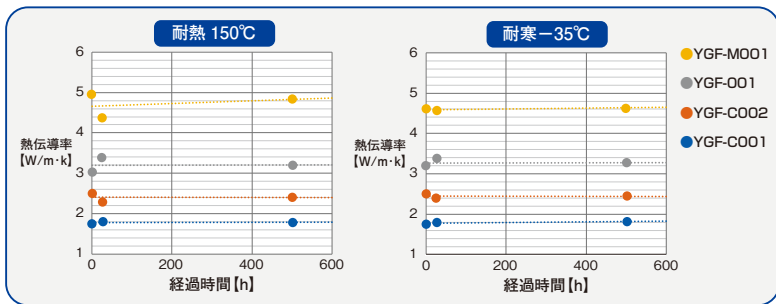
室温硬化

YGF series





	C series1 YG-C001 低放熱 安価	C series2 YG-C002 低放熱 安価	O series YG-001 低~中放熱	M series YG-M001 中放熱
粘度 (Pa・s)	—	—	200-300	400-500
比重	—	2.2	2.8	2.8
熱伝導率 (W/m・k) ※ASTM D5710-17 準拠	<b>1.8</b>	<b>2.5</b>	<b>3.2</b>	<b>4.6</b>
硬度 (Shore C)	40< (~80)			
絶縁破壊電圧 (kV/mm)	18			
表面抵抗値 (Ω/□)	1.0E+10 ~ 1.0E+11			
体積抵抗値 (Ω/□)	>1.0E+14			
誘電率 / 誘電正接	1MHz:6.34/0.035			
難燃性 (UL-94)	V-0 相当			
低分子シロキサン含有量 (ppm)	—			



	C series1 YGF-C001 低放熱 安価	C series2 YGF-C002 低放熱 安価	O series YGF-001 低~中放熱	M series YGF-M001 中放熱
混合比 (体積比)	1 : 1			
粘度 (Pa・s) A液	200-300	400-500	200-300	400-500
粘度 (Pa・s) B液	250-350	500-600	250-350	450-550
配合液 比重	2.0	2.2	2.8	2.8
熱伝導率 (W/m・k) ※ASTM D5710-17 準拠	<b>1.8</b> 150°C24h後 : 1.8 -35°C24h後 : 1.8	<b>2.5</b> 150°C24h後 : 2.5 -35°C24h後 : 2.5	<b>3.2</b> 150°C24h後 : 3.2 -35°C24h後 : 3.2	<b>4.6</b> 150°C24h後 : 4.6 -35°C24h後 : 4.6
ポットライフ (h)	0.5< (~6)			
室温硬化時間 (h)	(0.5 ~)>24			
硬度 (Shore C)	40< (~80)			
せん断強度 (MPa・s)	0.2< (~2.3)※基材 銅/アルミ			
絶縁破壊電圧 (kV/mm)	18			
表面抵抗値 (Ω/□)	1.0E+10 ~ 1.0E+11			
体積抵抗値 (Ω/□)	>1.0E+14			
誘電率 / 誘電正接	1MHz:6.34/0.035			
難燃性 (UL-94)	V-0 相当			
低分子シロキサン含有量 (ppm)	—			

◎ご要望に応じてカスタマイズ可能です。お気軽にご相談下さい。